Gudeng Precision Industrial Co. Ltd 家登精密工業股份有限公司





Partner with H.E.A.R.T., Grow with P.A.S.S.I.ON.

發言人:朱佳琳

電話:(02)2268-9141

郵件:Lynn.Chu@gudeng.com

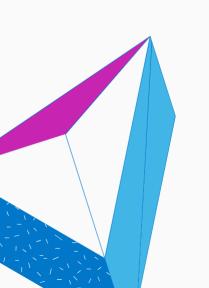


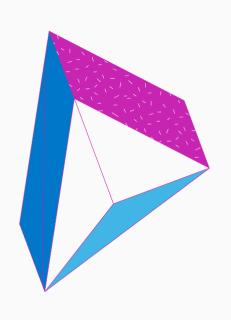


本資料可能包含對於未來展望的表述,是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知不確定性的影響,實際結果將可能於表述內容不同,以上所提供之所有資訊僅供參考,實際資料請參考公開資訊觀測站。

另除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。

大綱





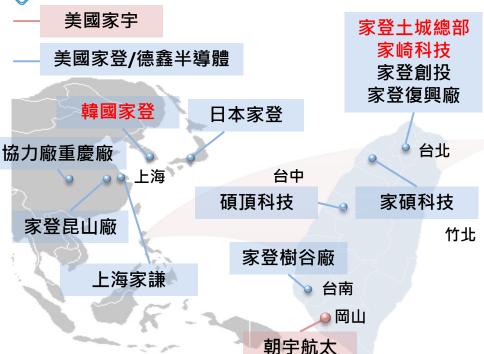
- 1 公司概況
- 2 市場布局
- 3 營運成果
- 4 營運展望

公司概況



家登-先進載具設備領航者





■ 成立於:1998年3月20日

■ 員工數: 1300 up

■ 實收資本額: NT 960,392,390

■ 集團2021營業額:NT 31.2 億元

■ 集團2022營業額:NT 44.9 億元

■ 集團2023營業額:NT 50.8 億元

■ 集團2024營業額:NT 65.5 億元

■ 集團2025 1~10月營業額:NT 57.37億元

■ 主力產品:

半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ②晶圓傳載解決方案
- ③ 先進封裝傳載解決方案
- ④ 半導體機台設備

航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



家登集團旗下企業



大中華地區:

上海家謙

昆山廠 重慶協力廠

日韓地區:

日本家登

久留米廠

韓國家登

美國地區:

美國家登



家登精密:

- · 光罩傳載解決方案
- 晶圓傳載解決方案
- 先進封裝傳載解決方案
- 半導體化學品相關產品及耗材

樹谷廠 復興廠 台中協力廠

花壇廠 龍福廠

家碩科技:

- 光罩盒充氣存儲設備
- 光罩清洗機

家崎科技:

- Cooling機台設備
- 半導體相關耗材

碩頂科技:

- 先進封裝傳載解決 方案

家宇航太:

- 液壓控制缸體零件
- 傳輸管件零件
- 航太相關特殊製程

市場布局



家登精密(3680)一站式解決方案







High-NA EUV Pod



Gudeng Phase II Pod Qualification

Test	Test Description/ specification	Phase II Pod	
Defectivity Shipping	Reticle FS QA → ≤ 1 adder ≥ 92 nm	1 F-S QA adder	
	Reticle FS non QA → ≤ 1 adder ≥ 100 nm	1 F-S nQA adders	
	Reticle BS → ≤ 22 adders ≥ 1000 nm	0 B-S adders	
	Reticle vertical sides @ 8 corners aligned with EIP pins \rightarrow no visible damage	No visible damage	
Functionality	Load Port → No errors due to EUV pod	No errors	
	RBI Functionality \rightarrow No RBI defects due to pod reflections	No RBI defects	
	Full Cycle → No errors due to EUV pod	No functionality error found	
Defectivity 100X PRP	Reticle FS QA → 0 adders due to pod	0 adders in QA due to pod	
	EIP contact points → 0 adders ≥ 25 μm LSE and no	0 contact pt adders	
	damage to reticle coating	No visible damage	
Defectivity RH cycle (2500)	Reticle FS QA → ≤1 adder ≥92nm LSE	Skipped	
	Reticle FS nQA → ≤50 adder ≥100nm LSE	(PRDM will be re-defined)	
	Reticle BS → ≤50 adder ≥1000nm LSE		
	EIP contact pts 0 adder ≥ 25 µm LSE		Pass
	No damage to reticle coating		In Progre
			Failed

ASML

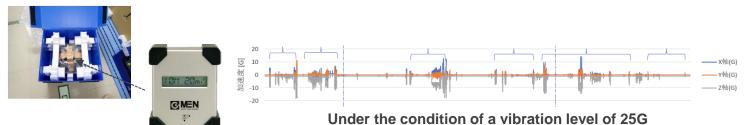
Page 2 Confidential



EUV POD Phase II Shipping Test Result



• The customer conducted a comparison of land and air shipping between Phase1 and Phase2.



最大Gの平均				
X軸	14.1			
Y軸	11.3			
Z軸	18.9			
合力	24.6			

EUV pod Phase1

Front Side Back Side QAContact QAContact 75 60 60 45 45 30 30 15 15 -15 -15 -30 -30 -45 -45

-60

-75

-75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75

EUV pod Phase2



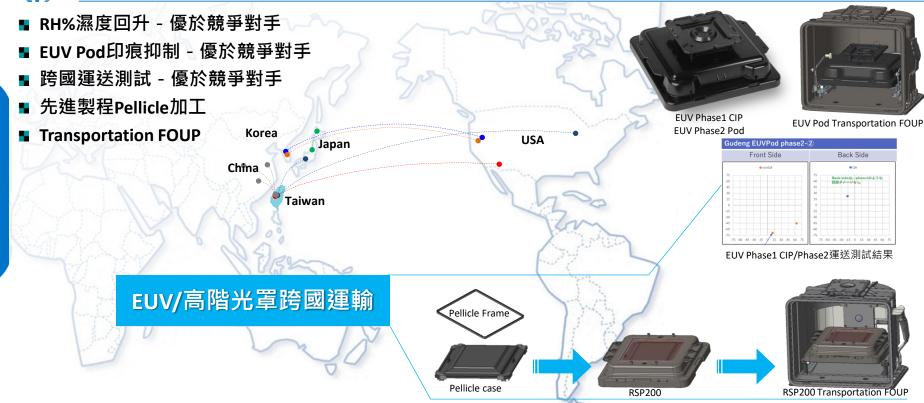
-60

-75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75



EUV Pod/Pellicle跨國運輸解決方案







>>> 大中華Blank/光罩傳載解決方案



- 塑膠射出工藝 產品減重35%
- 全平面設計,方便從盒外進行particle檢驗
- 內部無肋條設計,清洗不易殘水,縮短clean cycle time





光罩運輸盒

Blank/光罩傳載解決方案



6025 Blank多片盒 (PC紅透)



6025 Blank多片盒 (ABS紅透)



6025 Blank多片盒 (ABS黑色)



8512 組裝式大尺寸 光罩運輸盒



大尺寸光罩運輸盒

8514 組裝式大尺寸 光罩運輸盒



8092 Blank大尺寸 光罩運輸盒(全白)



8092 Blank大尺寸 光罩運輸盒(上黃下白)



光罩運輸盒

5280 大尺寸 光罩運輸盒



RSP/EUV612 開發進程



2022.07

2023.07

2023.10

2024.03

2024.04

2024.06













SEMICOM WEST discussed the 300 mm **Round Mask Potential**

ASML Share EXE5200 6x12" EUV scanner feasibility concept

Start 6x12" EUV Pod 3D design

6x12" LPOD design apply new design patent

2024 PMJ publish 6x12" **EUV LPOD design** concept & 1st prototype Gudeng is invited to start discussion the new SEMI Standard for 6x12" EUV **Reticle carrier**

2024.08

2024.09

2025.03

2025.09

2025.10

2025.12

2026.02

semi













SEMI "6x12 inch" Reticle **Carrier and Load Port Task Force Approval**

Start RSP612 3D design

SEMI "6x12 inch" Reticle **Carrier key technical** decisions confirm

Publish the 1st **RSP612 Prototype** Start RSP612 mold development

RSP612 molding

Molding product for potential customer



先進封裝技術-家登全系列解決方案





Silicon Interposer



Frame FOUP



Diffuser FOUP P300 FOUP



Chip on Panel FOUP

on Substrate





Panel FOUP

• 511*611



Panel FOUP

- 510*510
- 510*515

FoPLP

Glass Interposer



Quarter Panel FOUP

- 310*310
- 310"310
- 300*300
- 243*241
- 240*241
- 247*246
- 247*163



Panel FOUP

- 510*515
- Large Tray



TOSB

- 510*515
- 408*512



Panel FOUP

• 600*600



先進晶圓載具決勝關鍵



✓ 新品FOUP AMC 品質極優



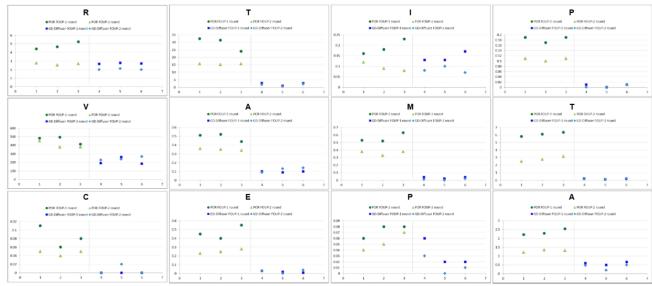














航太事業主力客戶







導管、逆止閥、緊固件 及相關加工零件,適用 於GE引擎件

Honeywell

提供**各式管件**及**連接管**等, 更於廠內進行化工處理及 特殊焊接工段



航太事業起源 「高進入障礙」 「高毛利市場」 「精密加工」



透過3~5軸車銑床加工技術,提供控制液壓零件,如缸體、腔體、活塞等







不僅提供**板金、加工零件和管件接頭**,更提供 塑膠射出產品



家登航太事業產品佈局





- · 引擎系統

各式飛機引擎使用之引擎五金零件, 運用於壓縮段、渦輪段、燃燒段



・液壓系統

飛機液壓控制系統之閥體、汽缸、 活塞、儲油槽



飛控系統

飛控系統使用之航電精密CNC零件,應用於致動器、伺服閥與姿態控制模組







燃油系統

飛機引擎外燃油傳輸模組與導氣 模組之高壓耐溫導管總成



緊固系統

各式引擎與結構組裝使用之 航太 級高強度緊固件,涵蓋螺桿、螺 帽與鎖固件





2026年航太事業展望



擴大特殊製程應用

- 持續開發特殊製程認證
- 提供一站購足的航太產品





抑制地緣政治風險

- 北美市場技術延伸據點
- 貴重金屬採購風控

提升產品位階

- 深化客我關係
- 邁向利基產品





切入新興產業

• 擴展航太製造技術應用

技術領先|全球韌性|價值升級|市場拓疆

營運成果



綜合損益表 YOY



	2025 Q3累計		2024 Q3累計	
營收	5,079,184	100%	5,070,466	100%
成本	2,983,998	59%	2,734,045	54%
毛利額	2,095,186	41%	2,336,421	46%
費用	1,395,670	27%	1,247,031	25%
淨利	699,516	14%	1,089,390	21%
營業外收入 及支出	(104,348)	(2)%	166,149	3%
稅前淨利	595,168	12%	1,255,539	25%
本年度淨利	462,012	9%	981,890	19%
EPS	4.20		9.63	

新台幣千元



家

登

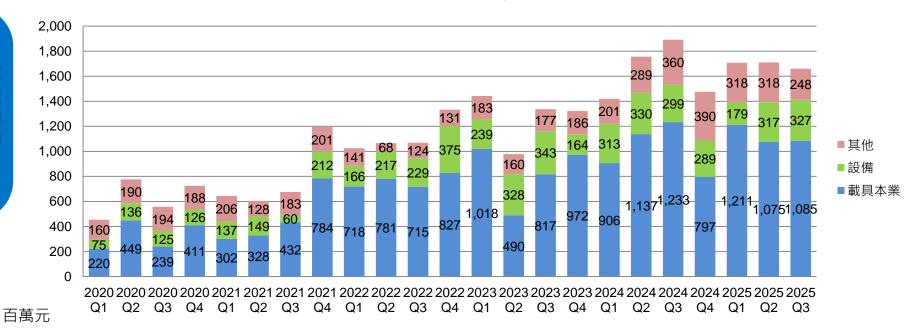
精

密

家登集團每季營收



家登集團合併營收

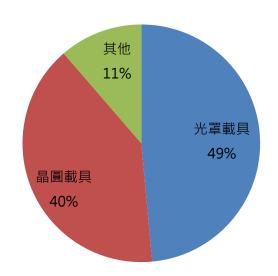




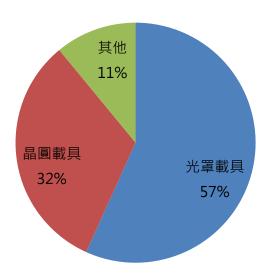
家登本業營收表現



2024 Q3



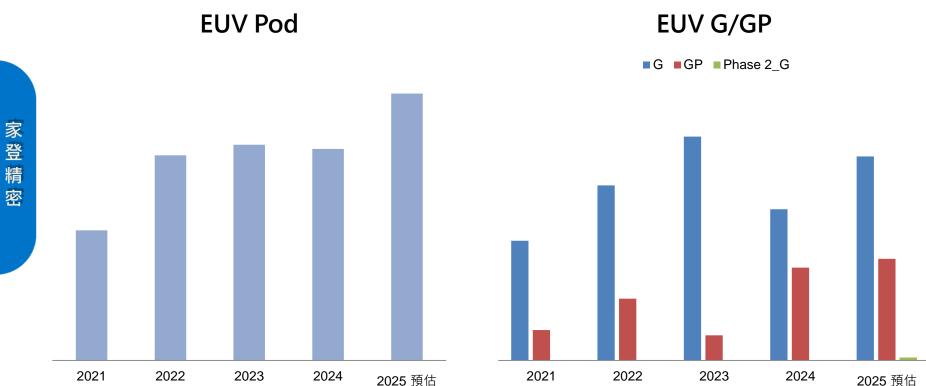
2025 Q3





家登本業營收表現_EUV Pod

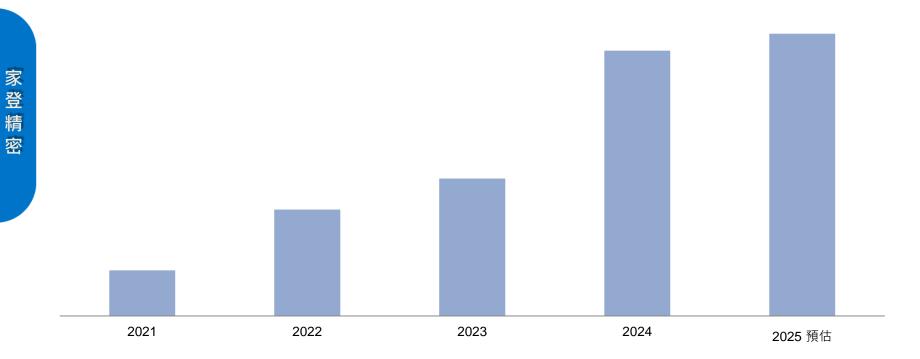




家登本業營收表現_FOUP



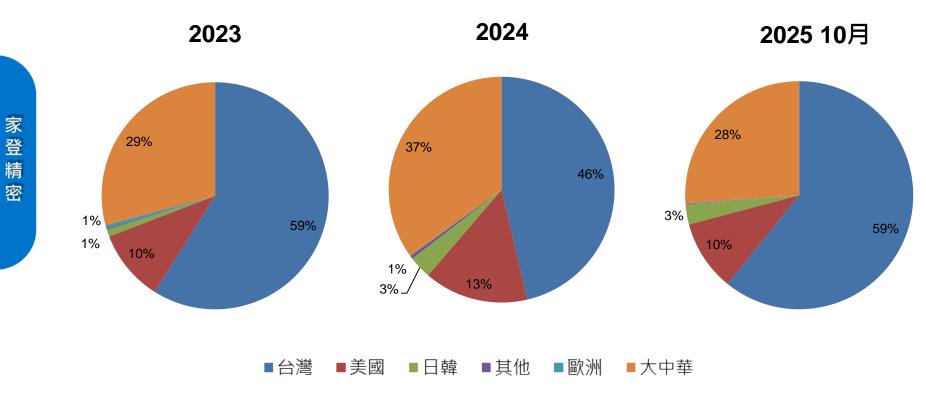
FOUP





家登本業營收地區表現







家登

精密

家登集團每季毛利





營運展望



家登ESG實踐績效









單位營收碳排量至 2024年減少45% (以2021年為基期)

單位營收用水量至 2024年減少67% (2021年為基期)

單位營收廢棄物至2024年 減少25% (2021年為基期)







次料循環利用專案,回收**再製棧板**、 運輸箱、人體工學椅

2024年員工平均年薪19個月

2024年投入20項社會公益 行動,效益達646萬元

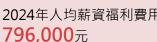








2024年人均薪資福利費用





家登永續報告書





導入ISO 22301、ISO 20400、ISO 27001

獲得品質領域最高榮譽 27th 國家品質獎

RBA行為準則 銀級認證





取得 TIPS A級 認證

家登集團多角化經營策略



EUV POD



FOUP



先進封裝



先進製程 設備耗材開發

to be uncovered

航太產品



半導體 化學品載具







Thank You www.gudeng.com